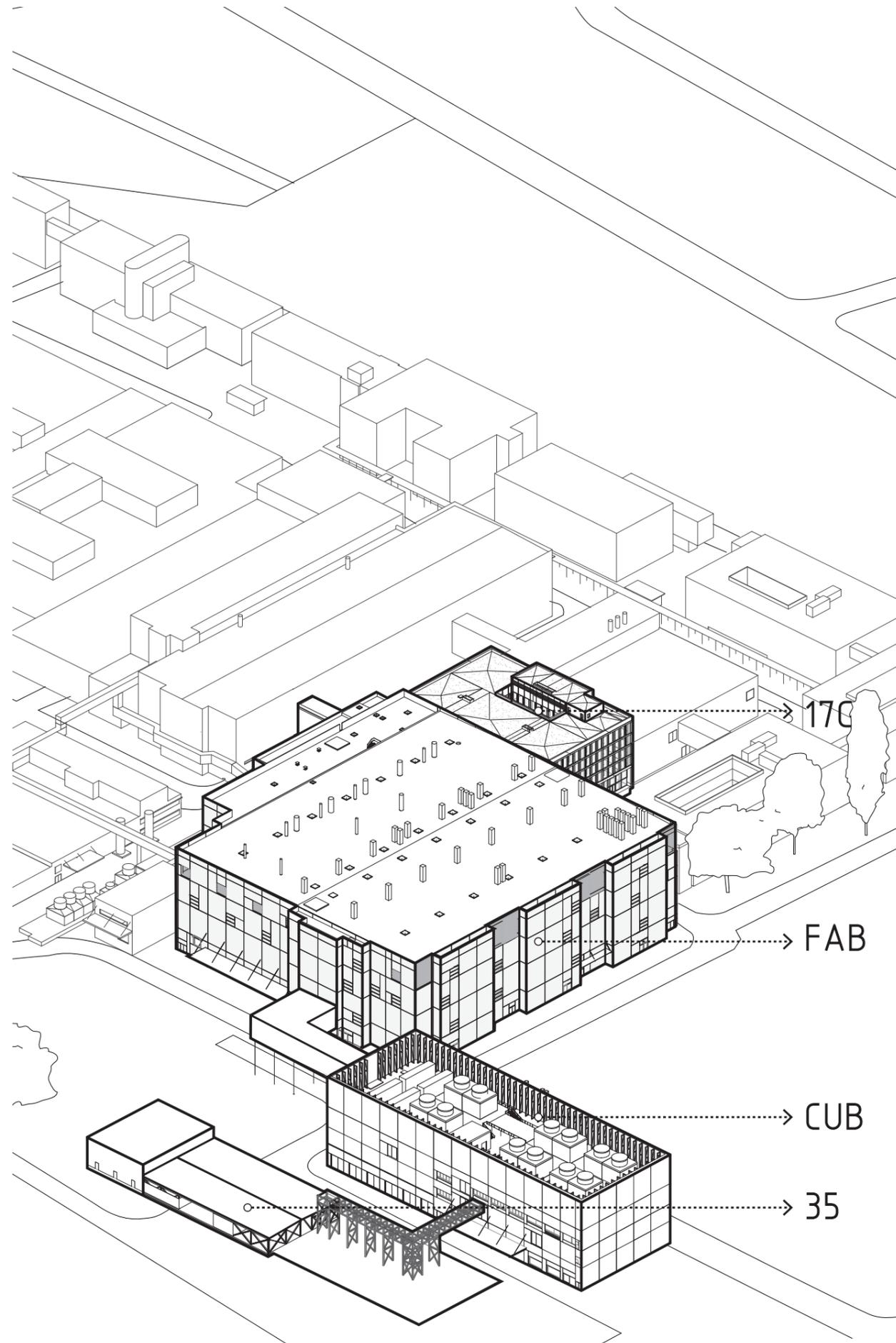




# Infineon Chipfabrik Villach



## Infineon Chipfabrik Villach

Projektart  
Neubau eines vollautomatisierten  
Chipwerks

Ort  
Villach, AUT

Bauherr  
Infineon Technologies Austria AG

Architektur  
Architects Collective  
HWP Planungsgesellschaft mbH  
UNIT 4

Fertigstellung  
2021

BGF  
105.000 m<sup>2</sup>

Category  
construction of a fully automated  
chip factory

Location  
Villach, AUT

Client  
Infineon Technologies Austria AG

Architecture  
Architects Collective  
HWP Planungsgesellschaft mbH  
UNIT 4

Completion  
2021

GFA  
105.000 m<sup>2</sup>

**Neue Dimensionen.** Der Technologiekonzern Infineon erweitert den Standort Villach durch ein neues, vollautomatisiertes Chipwerk für die Fertigung von Leistungshalbleitern auf 300 Millimeter-Dünnschichten. Für den Neubau, der unter anderem aus der 60.000 m<sup>2</sup> großen Reinraumfabrik mit zentralem Versorgungsgebäude, Büro- und Lagergebäude sowie Betriebsfeuerwehr besteht, investiert das Unternehmen in den kommenden Jahren rund 1,6 Milliarden Euro. Damit ist die Erweiterung das größte private Investitionsprojekt, das es in den letzten Jahrzehnten in Österreich gegeben hat.

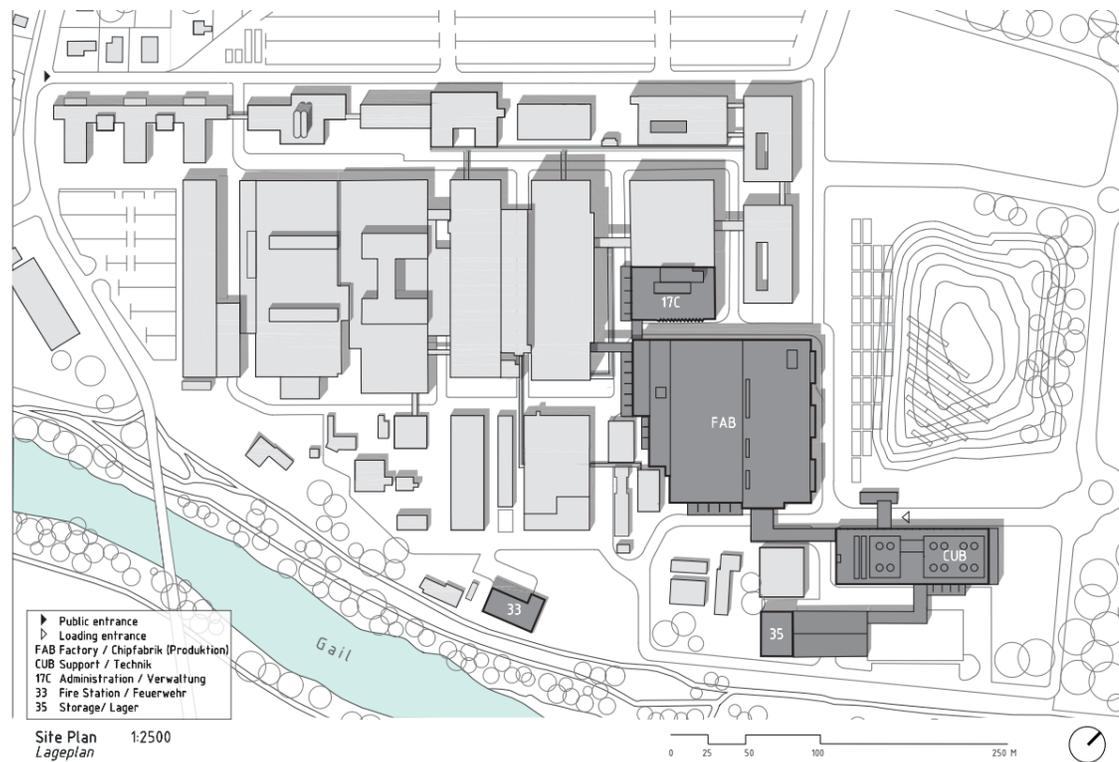
**Gezieltes Patchwork.** Aufgabe war, bei der Gestaltung der unterschiedlichen Bauten einerseits Bezug zu den Bestandsgebäuden zu nehmen, andererseits die große Baumasse zu gliedern und dabei den Neubauten einen eigenen, autarken Charakter zu verleihen. Um den deutlich größeren Maßstäben als beim Bestand entsprechen zu können und in Anlehnung an die bestehenden Verkleidungen mit Aluminiumwellen wird für die Fassaden der Neubauten ein Zackenprofil verwendet. Dabei werden die Aluminiumpaneele nicht einheitlich, sondern in unregelmäßigen Folgen auch um 90 Grad gedreht angelegt. Somit entsteht ein Patchwork-Muster, das die großen Volumina der Baukörper strukturiert und gleichzeitig auflockert. Je nach Tageszeit, Sonneneinstrahlung und Witterung erzeugt das Zackenprofil auch unterschiedliche Licht- und Schatteneffekte, die die Fassade zusätzlich beleben und ihr mehr Eleganz verleihen.

**New dimensions.** The hi-tech company Infineon expands the Austrian headquarters in Villach with a new, fully automated chip factory for the production of power semiconductors on 300-millimeter thin wafers. Over the next six years, the company will invest around 1.6 billion Euros for the new building, which includes the 60,000 m<sup>2</sup> cleanroom factory with central supply building, office and warehouse buildings and company fire brigade. The enlargement is the largest private investment project in Austria in recent decades.

**Patchwork Pattern.** In the design of the different buildings the task was to refer to the existing structures on the one hand, and to divide the large building stock on the other, thereby giving the new buildings their own, independent character. In order to be able to comply with the significantly larger scales than the existing stock and based on the existing cladding with aluminum shafts, a serrated profile is used for the facades of the new buildings. The aluminum panels are not uniform, but placed in irregular sequences, rotated by 90 degrees. This creates a patchwork pattern that structures and loosens the large volumes of the buildings. Depending on the time of day, sunshine and weather, the serrated profile also produces different light and shadow effects, which additionally liven up the facade and lend it more elegance.



Standorterweiterung Site expansion



Lageplan Site plan

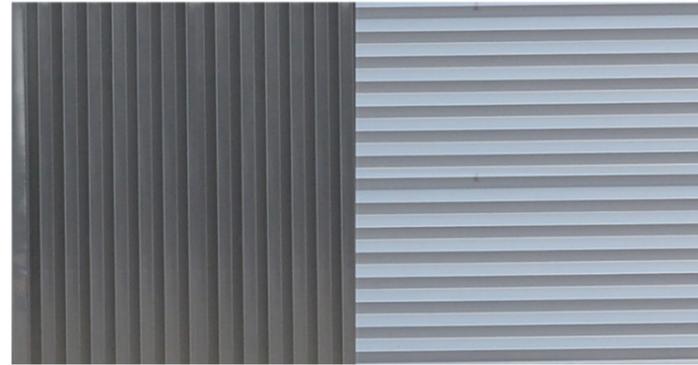


Bauteil 17C Building 17C



Bauteil FAB Building FAB

### Edelstahl / Niro



*vertikal*

*horizontal*

### Aluminium eloxiert

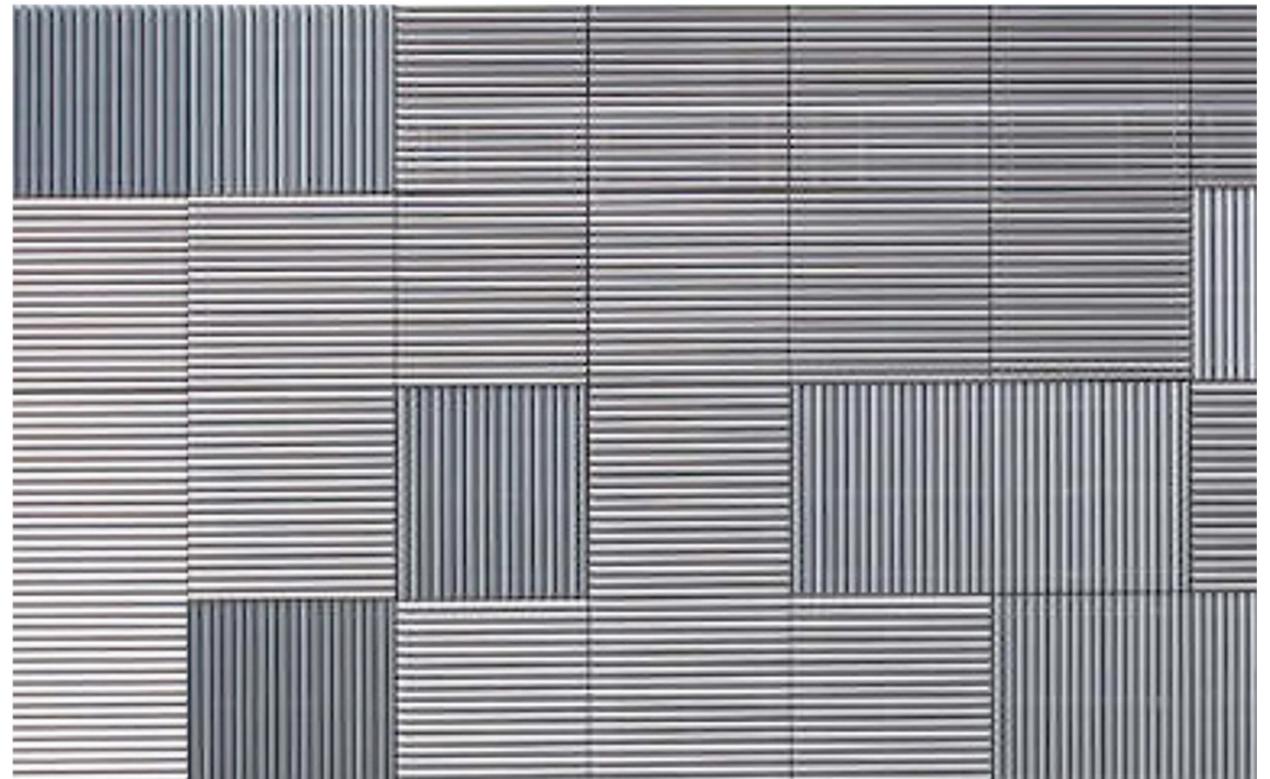


*vertikal*

*horizontal*



Bauteil CUB Building CUB



Spitzprofil Serrated profile